

FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



OMNIMATE® - Konektory mezi deskami

Flexibilní konstrukce kompaktních zařízení

Využití kontaktních systémů perspektivních pro budoucnost a optimalizace výrobních procesů jsou čím dál důležitější při vývoji efektivních průmyslových zařízení, obzvláště v oblasti Průmyslu 4.0. OMNIMATE® – konektory mezi deskami mají rozteč 1,27 mm a nabízejí maximální flexibilitu díky různým provedením.

- **Flexibilní design zařízení** - Pro průmysl vhodná hustota kombinovaná s vysoce flexibilními kombinacemi zapojení (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- **Připraveno pro automatizaci** - Vyvinuto pro automatickou montáž s vysoce přesnou rovinností pinů a fixací SMT
- **Spolehlivý kontakt** - Až 500 cyklů slícování díky průmyslově vhodnému pozlacenému povrchu (PdNi-Au)
- **Připraveno pro proces** - Vysoce výkonný LCP materiál pro pájení přetavením
- **Škálovatelnost** - Různé výšky s vysokým překrytím kontaktů zajišťují rozmanitá řešení od 12 – 80 pólů.
- **Robustní miniaturizace** - jednoduché a bezpečné spojení je možné dokonce i za nepříznivých podmínek slícování – např. sklon nebo odsazení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, řada zdírek, Pájené připojení SMD, Rozteč v mm (P): 1.27 mm, Počet pólů: 50, 180°, Tape
Objednací číslo	2747400000
Typ	FFH9 S1/50V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000914
Množství	280 ks
Údaje výrobku	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Balení	Tape

FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,307 inch
Výška	9,9 mm	Výška (v palcích)	0,39 inch
Šířka	36,83 mm	Šířka (v palcích)	1,45 inch
Čistá hmotnost	7,432 g		

Jmenovité údaje podle UL 1977

Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.	Jmenovité napětí (UL 1977) (zastaralé)	150 V
--------------------------------	--	--	-------

Balení

Balení	Tape	Délka VPE	350 mm
Šířka VPE	340 mm	Výška VPE	135 mm

Parametry systému

Přenosová rychlost	3,125 Gbit/s	Skupina produktů	Signál OMNIMATE – mezi deskami
Typ připojení	Připojení desky	Montáž na PCB desku	Pájené připojení SMD
Rozteč v mm (P)	1,27 mm	Rozteč v palcích (P)	0,05 "
Výstupní tvarovka	180°	Počet pólů	50
Počet pájených kolíků na pól	1	Koplanarita:	0,1 mm
Počet řad	1	Množství řady kolíků	2
Stupeň krytí	IP20	Objemový odpor	<25 mΩ
Cykly zapojování	500	Zásuvná síla / pól, max.	0,6 N
Tažná síla / pól, max.	0,6 N		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	LCP	Barevný	černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Izolační síla	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Contact base material	Slitina mědi
Materiál kontaktu	Slitina	Povrch kontaktu	Pozlacený nikl
Struktura vrstev kontaktu konektoru	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m Pd-Ni} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-55 °C
Provozní teplota, max.	125 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	2,8 A	Povrchová vzdálenost, min.	0,4 mm
Vzdušná vzdálenost, min.	0,4 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Důležitá poznámka

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

Web UL

Č. osvědčení (cURus)

E92202

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Oznámení o změně produktu

[Technische Änderung für Board-to-Board Steckverbinder - Lötstiftlänge und PPP](#)
[Technical change to Board-to-Board connectors - solder pin length and PPP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

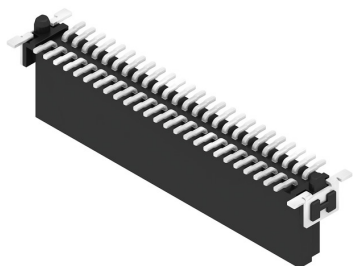
FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

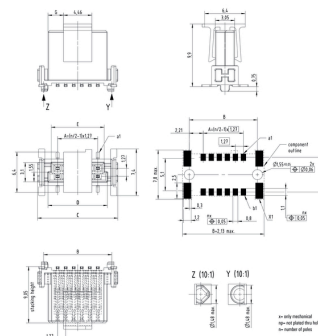
Nákresy

Obrázek výrobku

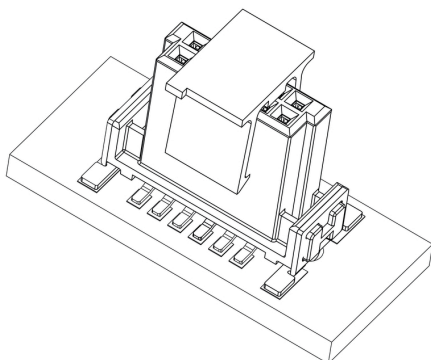


Dimensional drawing

Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E	S
FFH9 S1/12V F1 B RL	2747500000	12	6,35	10,17	12,7	9,37	6,37	2,46
FFH9 S1/18V F1 B RL	2747500000	18	6,35	12,21	15,04	11,91	6,61	2,73
FFH9 S1/20V F1 B RL	2747500000	20	11,43	10,65	17,19	14,45	13,45	5
FFH9 S1/20V F1 B RL	2747510000	20	16,51	10,65	21,59	16,26	17,26	7,64
FFH9 S1/25V F1 B RL	2747500000	25	16,51	22,67	26,5	22,67	21,07	6,81
FFH9 S1/30V F1 B RL	2747500000	30	26,15	26,55	30,48	27,15	26,15	11,25
FFH9 S1/30V F1 B RL	2747510000	30	36,48	26,55	36,48	33,5	33,5	15,15
FFH9 S1/50V F1 B RL	2747410000	60	41,91	46,33	48,26	44,93	43,93	20,24
FFH9 S1/50V F1 B RL	2747420000	60	46,33	53,95	55,08	52,15	51,15	23,65



Detailní výkres



Křivka odlehčení



FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Extender-Board



Mezzanine



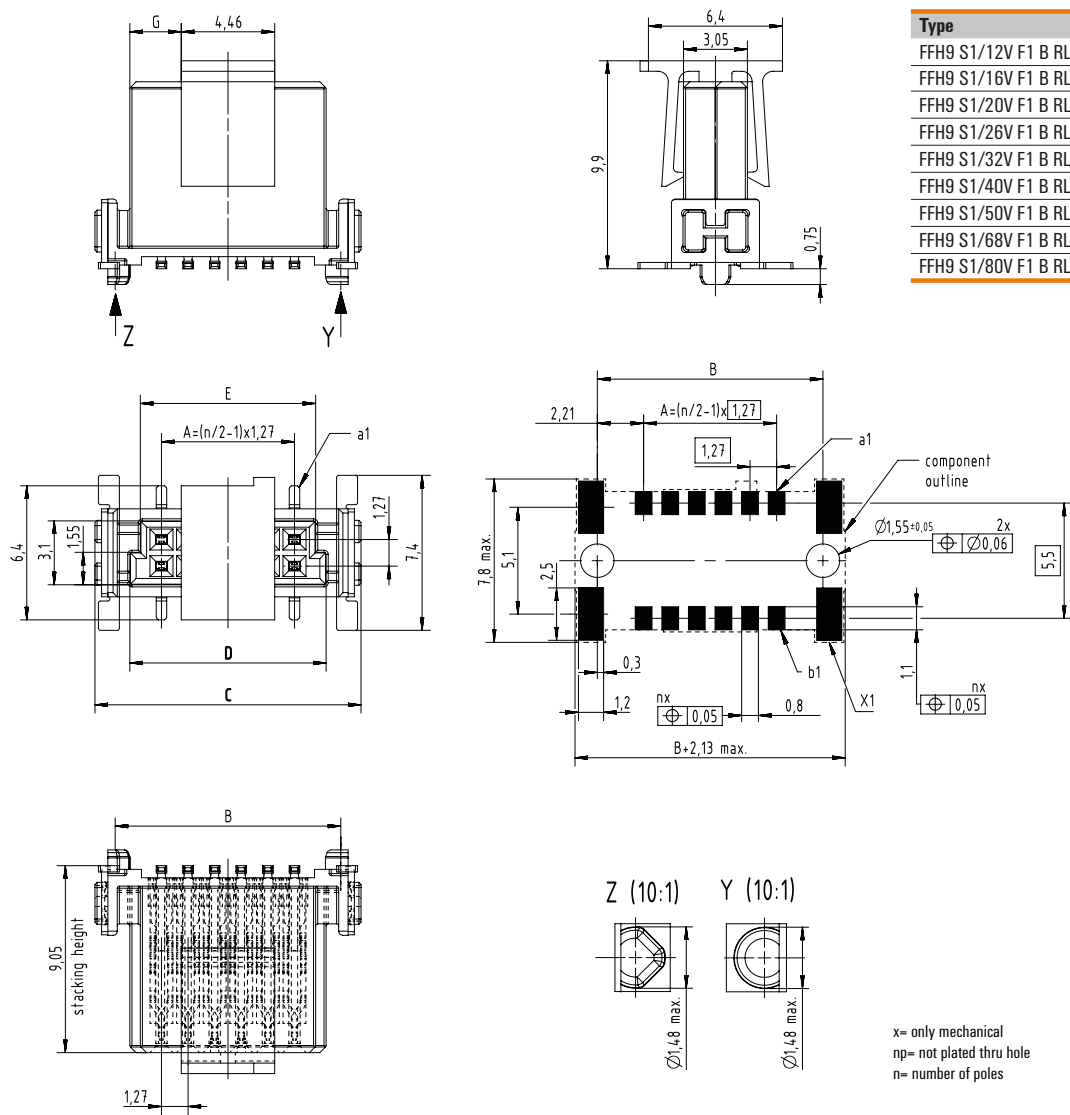
Mother-to-Daughter



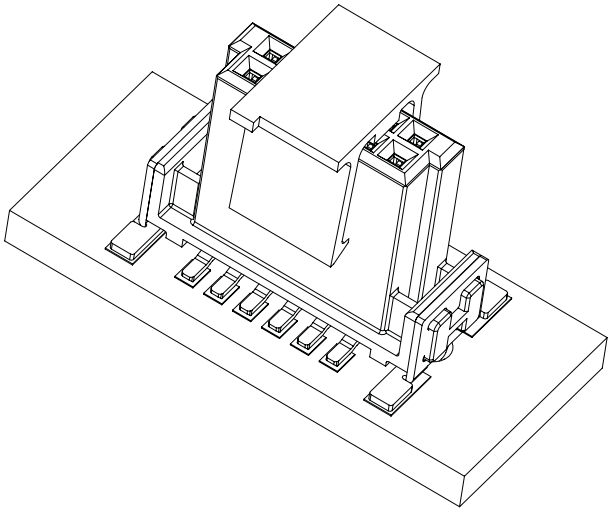
Board-to-Wire



FFH9 S1/..V F1 B RL



Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E	G
FFH9 S1/12V F1 B RL	2747340000	12	6,35	10,77	12,7	9,37	8,37	2,46
FFH9 S1/16V F1 B RL	2747350000	16	8,89	13,31	15,24	11,91	10,91	3,73
FFH9 S1/20V F1 B RL	2747360000	20	11,43	15,85	17,78	14,45	13,45	5
FFH9 S1/26V F1 B RL	2747370000	26	15,24	19,66	21,59	18,26	17,26	7,54
FFH9 S1/32V F1 B RL	2747380000	32	19,5	23,47	25,4	22,07	21,07	8,81
FFH9 S1/40V F1 B RL	2747390000	40	24,13	28,55	30,48	27,15	26,15	11,35
FFH9 S1/50V F1 B RL	2747400000	50	30,48	34,29	36,83	33,5	32,5	15,16
FFH9 S1/68V F1 B RL	2747410000	68	41,91	46,33	48,26	44,93	43,93	20,24
FFH9 S1/80V F1 B RL	2747420000	80	49,53	53,95	55,88	52,55	51,55	24,05



Female vertical - FFH6 | FFH9

Application - dimensions

	14 mm				
	13 mm				
	12 mm				
	11 mm				
	10 mm				
	9 mm				
	8 mm				
X	stacking	male 1,75mm	male 3,25mm	male 1,75mm	male 3,25mm
Y	heights	female 6,25mm	female 6,25mm	female 9,05mm	female 9,05mm
S	PCB distance	8mm - 9,5mm	9,5mm - 11mm	10,8mm - 12,3mm	12,3mm - 13,8mm
Type		FMH1..	FMH3..	FMH1..	FMH3..
		FFH6..	FFH6..	FFH9..	FFH9..

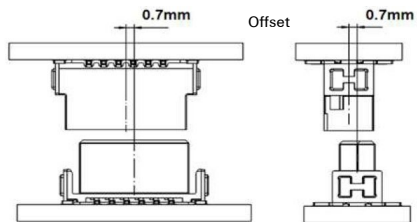


*S max. = S min. + 1,15 wiping length with additional contact overlap security

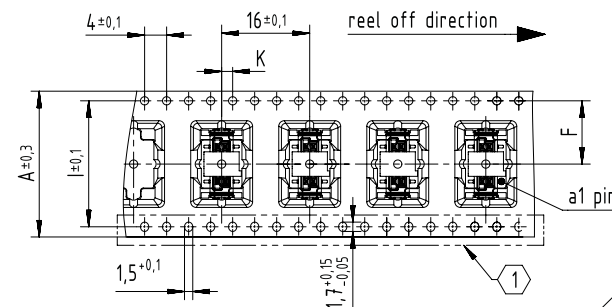


X	Y	S min.	*S max.	P min.	O
3,25	9,05	12,3	13,8	-	-
1,75	9,05	10,8	12,3	-	-
3,25	6,25	9,5	11	-	-
1,75	6,25	8	9,5	-	-
-	9,05	-	-	10,5	14,33
-	6,25	-	-	7,7	11,53

Mating conditions



Tape - dimensions

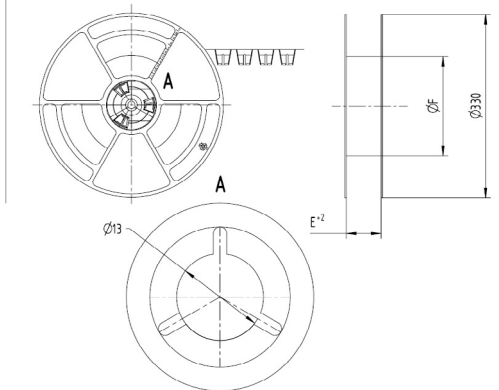


Tape dimensions	A	F	I	K
Pole 12	24,0	11,5 ± 0,1	-	2 ± 0,1
Poles 14 to 20	32,0	14,2 ± 0,1	28,4	2 ± 0,1
Poles 22 to 40	44,0	20,2 ± 0,15	40,2	2 ± 0,15
Poles 42 to 56	56,0	26,2 ± 0,15	52,4	2 ± 0,15
Poles 58 to 80	72,0	34,2 ± 0,3	68,4	2 ± 0,2

① No double sprocket holes for 12 pole numbers (tape size 24)



Reel - dimensions



Reel dimensions	E	F
Pole 12	24,4	
Poles 14 to 20	32,4	
Poles 22 to 40	44,4	178mm for stacking height
Poles 42 to 56	56,4	1,75mm & 3,25mm
Poles 58 to 80	72,4	

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.